

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2011-018

北京君正集成电路股份有限公司
关于“获得集成电路产业研究与开发专项资金
研发资助”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国财政部下发的《关于 2011 年度集成电路产业研究与开发专项资金申报事项的通知》（财办建[2011]71 号）。根据该通知要求，公司申请承担“便携多媒体终端核心芯片的研发”项目（以下简称“项目”），并由中华人民共和国工业和信息化部核定公司承担此项目。项目实施周期两年，专项经费预算 1,500 万元，公司于近日一次性收到该笔项目补助资金 1,500 万元。

上述补助资金将根据《企业会计准则》的规定列入递延收益科目，并根据项目执行进度结转入营业外收入。根据项目进展情况，部分资金将于今年计入营业外收入，对 2011 年度利润产生一定影响。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十九日